行业研究

行业研究周报

申港证券股份有限公司证券研究报告

国内加速布局光刻胶 光刻胶行业任重而道远

——电子

申港证券 SHENGANG SECURITIES

投资摘要：

市场回顾：

本周（2020.11.02-2020.11.08）上证指数上涨 2.72%，深证成指上涨 4.55%，创业板指上涨 2.91%，申万电子指数上涨 6.51%，位列申万 28 个一级行业周涨跌幅第 5 位。目前，电子板块 TTM 市盈率为 51.2 倍，位列申万 28 个一级行业的第 4 位。

- 股价涨幅前五名：民德电子、聚灿光电、诺德股份、金龙机电、四会富仕；
- 股价跌幅前五名：卓翼科技、同兴达、英唐智控、*ST 飞乐、英飞特。

每周一谈：国内加速布局光刻胶 光刻胶行业任重而道远

近期，上海新阳、南大光电发布公告，加码光刻胶项目的研发与产业化。上海新阳主要目标为实现 ArF 干法工艺使用的光刻胶和面向 3D NAND 台阶刻蚀的 KrF 厚膜光刻胶的产业化，南大光电目标达到年产 25 吨 193nm 光刻胶产品的生产规模，产品性能满足 90nm-14nm 集成电路制造的要求。

目前全球光刻胶市场日本处于领先地位。日本的 JSR、东京应化、信越化学及富士电子四家企业占据了全球 70%以上的市场份额，处于市场垄断地位。

国内光刻胶生产商主要生产 PCB 光刻胶，面板光刻胶和半导体光刻胶生产规模相对较小。国内生产的光刻胶中，PCB 光刻胶占比 94%，LCD 光刻胶和半导体光刻胶占比分别仅有 3%和 2%。

半导体用光刻胶按不同制程可分为 EUV 光刻胶、ArF 光刻胶、KrF 光刻胶及 G 线、i 线光刻胶。由于在研发光刻胶的过程中需要有对应光刻机的支持，规模量产后需要在光刻机上不断调试。而先进光刻机价格昂贵，国内半导体材料公司难以承受，**目前高端光刻胶基本被日本及欧美垄断，国内半导体光刻胶主要集中在低端的 g 线、i 线光刻胶。**

- **EUV 光刻胶：**目前市场上最高端的光刻胶，与 EUV 光刻胶配合使用。在 EUV 光刻胶领域，日本企业处于绝对垄断地位。日本的 JSR、信越化学、东京应化(TOK)等 3 家公司占全球 EUV 市场份额的 90%以上。在 EUV 光刻胶领域，由于缺乏 EUV 光刻机的支持，目前国内还未开始涉及。
- **ArF 光刻胶：**国内北京科华、南大光电及上海新阳都开启相关研究，但目前还处于研发阶段。ArF 光刻胶也主要被日本的 JSR、信越化学、东京应化(TOK) 3 家公司占领。
- **KrF 光刻胶：**国内北京科华的 KrF（248nm）光刻胶已经通过包括中芯国际在内的部分客户认证，并实现批量供货；晶瑞股份子公司苏州瑞红目前已进入中试阶段，但还未实现量产供货。
- **G 线、i 线光刻胶：**目前北京科华和晶瑞股份子公司苏州瑞红都已实现量产供货。

投资策略及组合：在半导体光刻胶领域，国内与国外差距明显，国产替代任重而道远。我们建议关注半导体领域龙头公司，推荐组合：兆易创新、韦尔股份、华峰测控、安集科技、闻泰科技各 20%。

风险提示：下游需求低于预期；行业发展低于预期；疫情影响大于预期。

评级　　增持（维持）

2020 年 11 月 09 日

曹旭特　　分析师

SAC 执业证书编号：S1660519040001

行业基本资料

股票家数	296
行业平均市盈率	46.32
市场平均市盈率	22.41

行业表现走势图



资料来源：申港证券研究所

相关报告

1、《电子行业研究周报：新能源汽车推动 SiC 材料器件快速增长》2020-11-02

2、《电子行业研究周报：从 SK 海力士收购 Intel NAND 业务看全球 NAND 格局》2020-10-26

3、《电子行业研究周报：晶圆代工需求旺盛 台积电中芯国际营收大增》2020-10-19

1. 每周一谈：国内加速布局光刻胶 光刻胶行业任重而道远

1.1 上海新阳、南大光电加码光刻胶项目

11 月 3 日，上海新阳发布公告，公司拟向特定对象发行股票不超过 87,194,674 股（含本数），募集资金总额预计不超过 145,000.00 万元（含本数）。扣除发行费用后拟将 8.15 亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，3.35 亿元用于集成电路关键工艺材料项目，3.00 亿元用于补充公司流动资金。

上海新阳本次向特定对象发行募集资金拟将部分资金投资于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，主要目标为**实现 ArF 干法工艺使用的光刻胶和面向 3D NAND 台阶刻蚀的 KrF 厚膜光刻胶的产业化**。

11 月 7 日，南大光电发布公告，公司拟向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 63,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于光刻胶项目、扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目以及补充流动资金。本次募投项目包含“先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产业化”、“ArF 光刻胶产品的开发和产业化”，通过募集资金对光刻胶业务的投资建设，**公司将达到年产 25 吨 193nm（ArF 干式和浸没式）光刻胶产品的生产规模，产品性能满足 90nm-14nm 集成电路制造的要求**，实现高端光刻胶生产的完全国产化和量产零的突破，提升我国高端光刻胶这一领域的自主可控水平。

表1：南大光电募集资金用途（单位：万元）

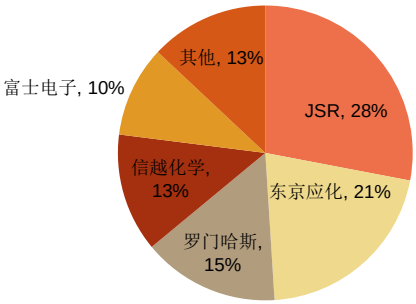
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额
1	光刻胶项目	66,000.00	15,000.00
1.1	先进光刻胶及高纯配套材料的开发和产业化	41,000.00	15,000.00
1.2	ArF 光刻胶产品的开发和产业化	25,000.00	
2	扩建 2000 吨/年三氟化氮生产装置项目	30,000.00	30,000.00
3	补充流动资金	18,500.00	18,500.00
合计		114,500.00	63,500.00

资料来源：南大光电公司公告，申港证券研究所

1.2 光刻胶领域日本处于领先地位

目前全球光刻胶市场日本处于垄断地位。光刻胶属于高技术壁垒材料，生产工艺复杂，纯度要求高，需要长期的技术积累。日本的 JSR、东京应化、信越化学及富士电子四家企业占据了全球 70%以上的市场份额，处于市场垄断地位。

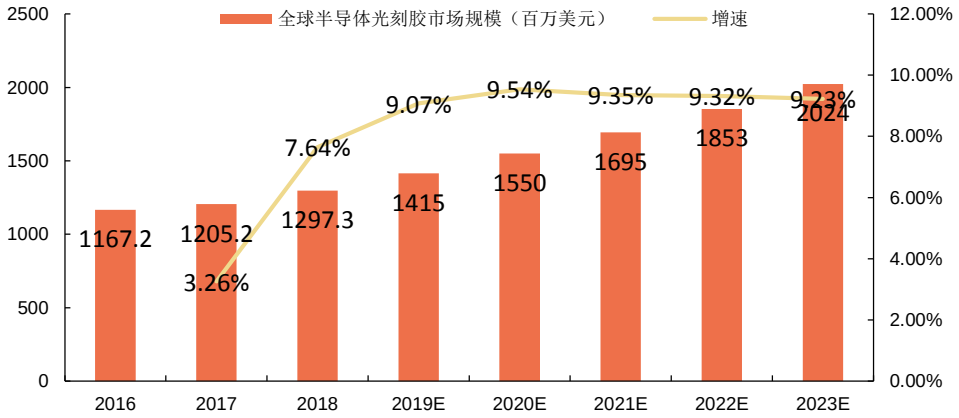
图1：全球光刻胶企业市场占比



资料来源：新材料在线，申港证券研究所

光刻胶市场需求逐年增加，2018 年全球半导体光刻胶销售额 12.97 亿美元。随着下游应用功率半导体、传感器、存储器等需求扩大，未来光刻胶市场将持续扩大。

图2：全球半导体光刻胶市场规模及预测



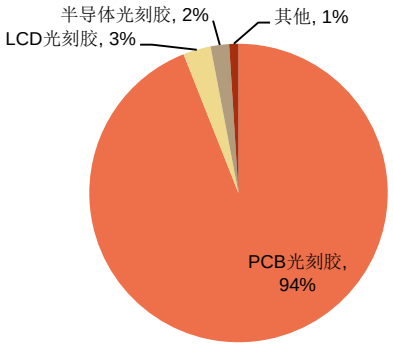
资料来源：前瞻产业研究院，申港证券研究所

由于光刻胶的技术壁垒较高，国内高端光刻胶市场基本被国外企业垄断。特别是高分辨率的 KrF 和 ArF 光刻胶，基本被日本和美国企业占据。

1.3 国内光刻胶以 PCB 光刻胶为主

国内光刻胶生产商主要生产 PCB 光刻胶，面板光刻胶和半导体光刻胶生产规模相对较小。国内生产的光刻胶中，PCB 光刻胶占比 94%，LCD 光刻胶和半导体光刻胶占比分别仅有 3%和 2%。

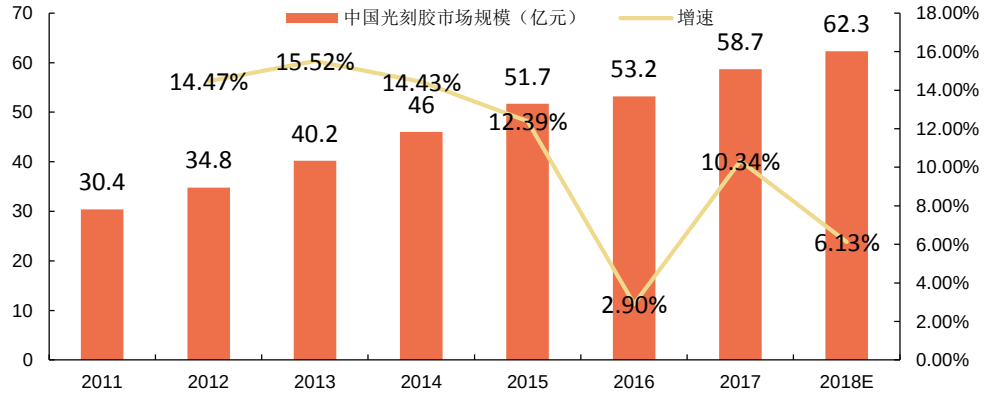
图3：国内光刻胶产品情况



资料来源：前瞻产业研究院，申港证券研究所

国内光刻胶市场规模保持稳定增长，从 2011 年的 30.4 亿元增长到 2018 年的 62.3 亿元，复合增长率达 11.59%。预计 2018 年国内光刻胶市场规模约为 62.3 亿元。

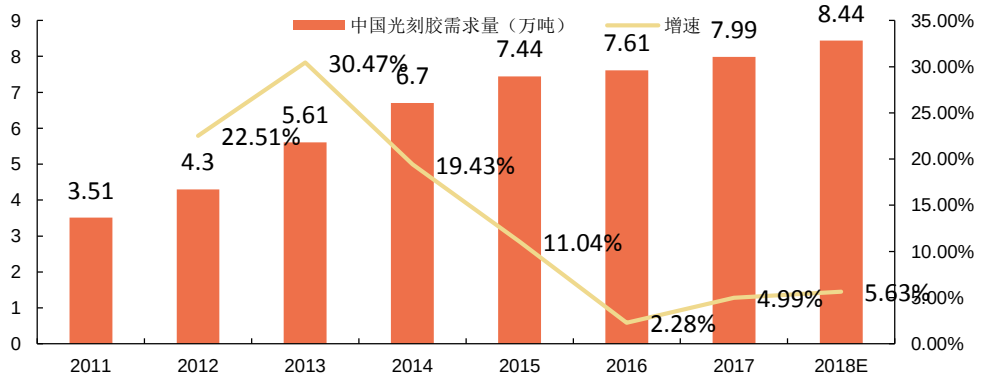
图4：中国光刻胶市场规模及增速



资料来源：前瞻产业研究院，申港证券研究所

国内光刻胶需求量方面，2011 年光刻胶需求量为 3.51 万吨，到 2017 年需求量为 7.99 万吨，年复合增长率达 14.69%。2018 年国内光刻胶需求量预计为 8.44 万吨。

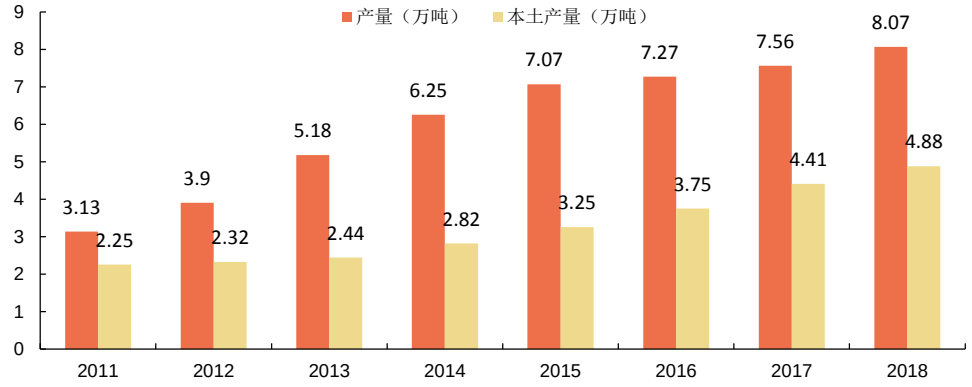
图5：中国光刻胶需求量及增速



资料来源：前瞻产业研究院，申港证券研究所

国内光刻胶需求量远大于本土产量，且差额逐年扩大。由于国内光刻胶起步晚，目前技术水平相对落后，生产产能主要集中在 PCB 光刻胶、TN/STN-LCD 光刻胶等中低端产品，TFT-LCD、半导体光刻胶等高技术壁垒产品产能极少，仍需大量进口，从而导致国内光刻胶需求量远大于本土产量。

图6：国内光刻胶产量及本土产量情况



资料来源：前瞻产业研究院，申港证券研究所

1.4 投资策略

在光刻胶领域，目前国内光刻胶主要集中 PCB 应用领域。半导体光刻胶由于技术壁垒高，研发难度大，且需要有对应的光刻机作支持，目前主要被日本及欧美国家占领。

半导体光刻胶目前国内仅有北京科华和晶瑞股份子公司苏州瑞红实现量产供货，且主要集中在低端的 g 线、i 线光刻胶。在高端光刻胶领域，EUV 光刻胶国内还未开始涉及，ArF 光刻胶国内才刚开始研发，距离量产供应还远，光刻胶领域国内与国外技术差距明显，国产替代任重而道远。

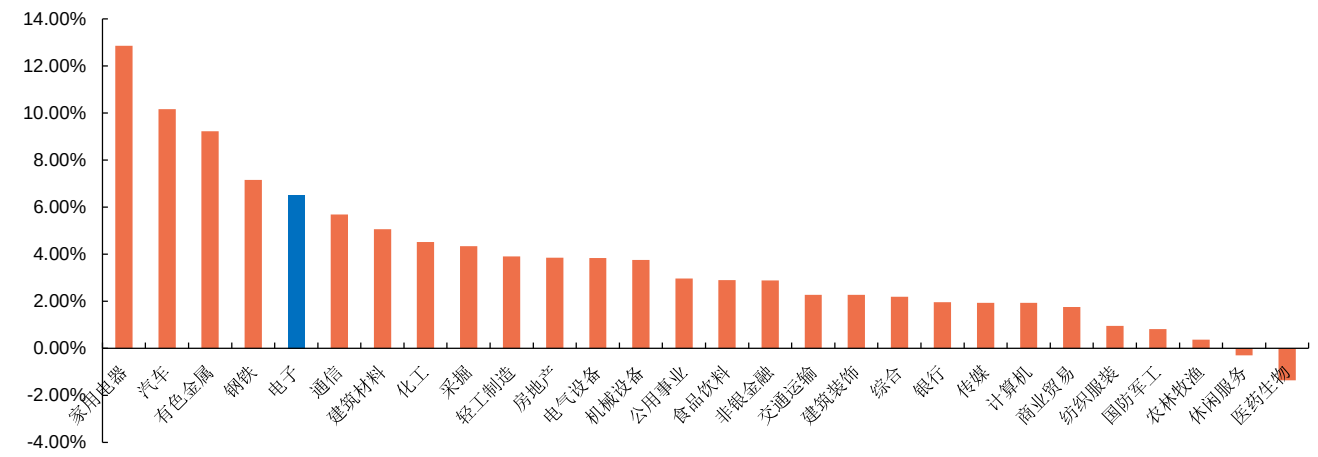
投资策略上，我们建议关注半导体领域龙头公司，建议关注兆易创新、韦尔股份、安集科技、闻泰科技等。

2. 市场回顾

本周（2020.11.02-2020.11.08）上证指数上涨 2.72%，深证成指上涨 4.55%，创业板指上涨 2.91%，申万电子指数上涨 6.51%，位列申万 28 个一级行业周涨跌幅第 5 位。目前，电子板块 TTM 市盈率为 51.2 倍，位列申万 28 个一级行业的第 4 位。

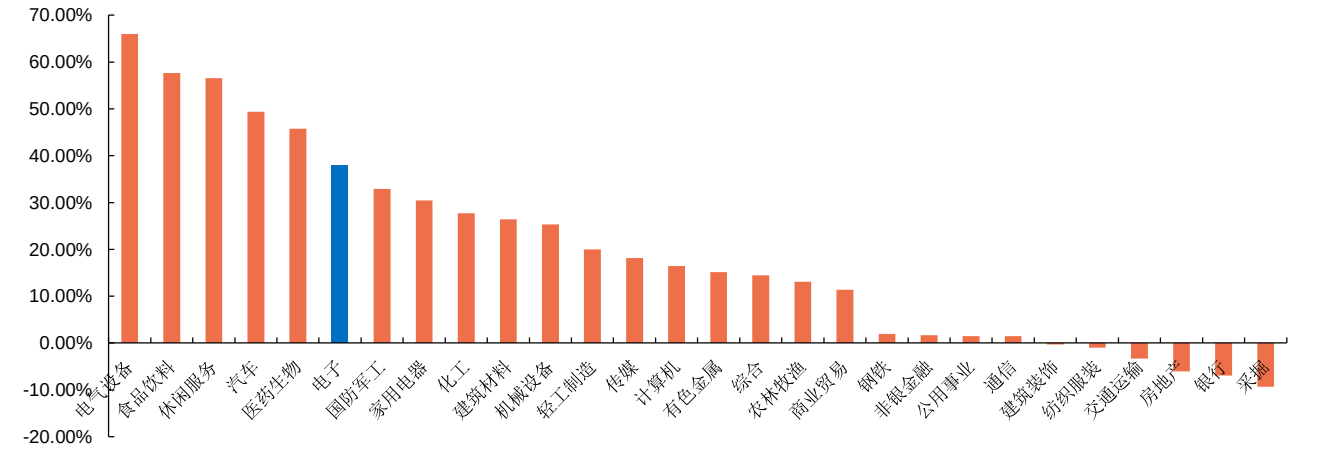
自 2020 年以来，上证综指、深证成指、创业板指、申万电子指数分别上涨 8.95%、32.67%、52.00%、38.02%，电子指数在申万一级行业涨跌幅排名第 6 位。

图7：申万一级行业指数周涨跌幅



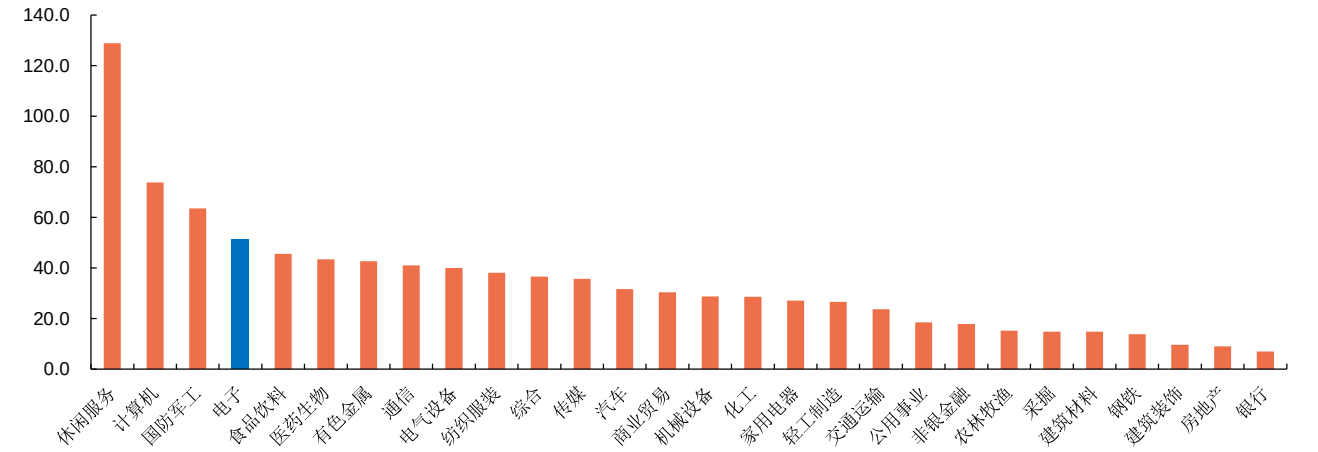
资料来源：wind，申港证券研究所

图8：申万一级行业今年以来涨跌幅对比



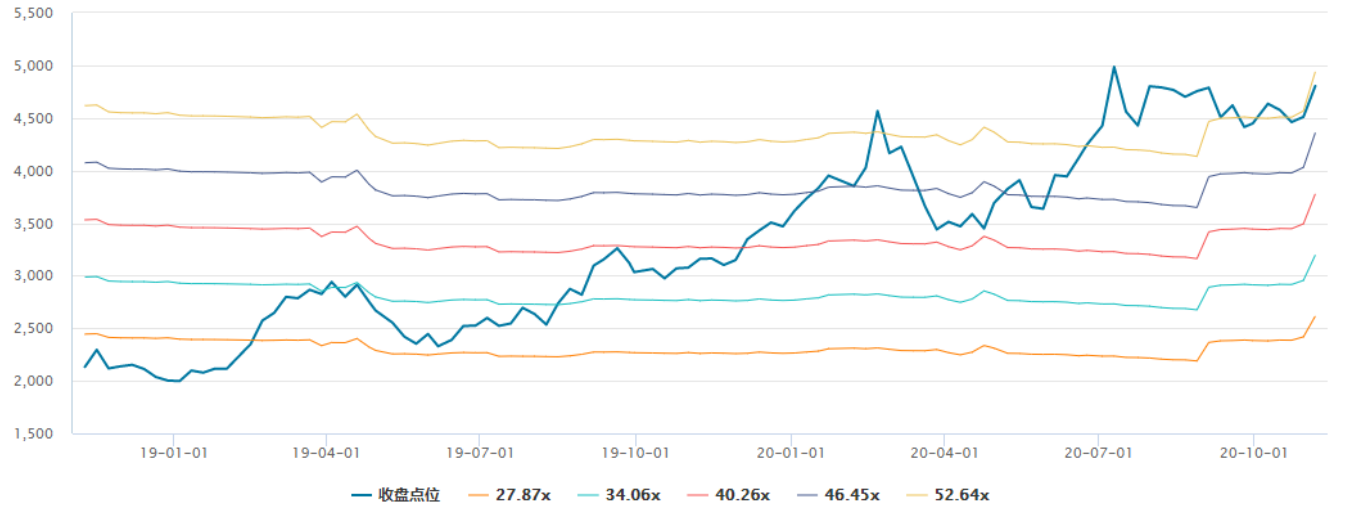
资料来源：wind，申港证券研究所

图9：申万一级行业 PE（TTM）对比



资料来源：wind，申港证券研究所

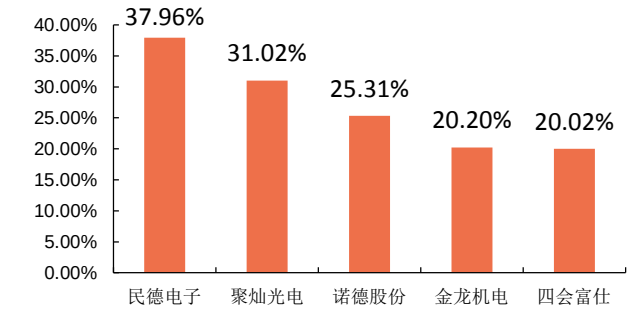
图10：电子行业估值水平（PE-TTM）



资料来源：wind，申港证券研究所

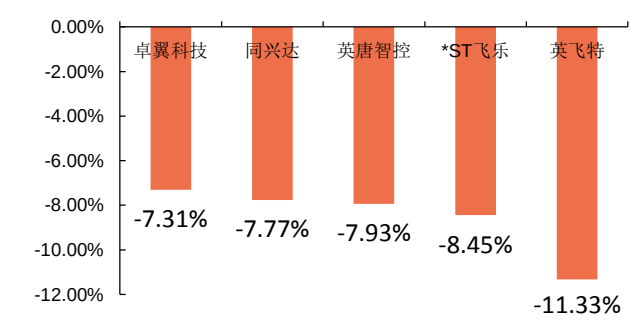
个股方面，本周涨幅前五的股票是民德电子、聚灿光电、诺德股份、金龙机电、四会富仕；跌幅靠前的是卓翼科技、同兴达、英唐智控、*ST 飞乐、英飞特。

图11：SW 电子成分本周涨幅前 5



资料来源：wind，申港证券研究所

图12：SW 电子成分本周跌幅前 5



资料来源：wind，申港证券研究所

3. 行业新闻

3.1 半导体

英飞凌在进博会上宣布最新在华投资计划。英飞凌在第三届中国国际进口博览会上宣布，将新增在华投资，扩大其无锡工厂的 IGBT 模块生产线。无锡工厂扩产后，将成为英飞凌最大的 IGBT 生产基地之一。英飞凌将以更丰富的 IGBT 产品线，满足快速增长的可再生能源、新能源汽车等领域的应用需求。建成后的新生产制造中心将生产用于电动汽车的 HybridPACK™双面冷却模块，用于风电、光伏及众多工业应用的 EasyPACK™ 1A/2A 模块和 1B/1B 模块，用于家电和工业等领域的 CIPOS™ Mini 智能功率模块（IPM）等功率模块器件。其中，HybridPACK™双面冷却模块是英飞凌全新的 IGBT 产品，可应用于混合动力及电动汽车的主逆变器和充放电。目前该模块已成功用于全球多款插电式混动、电动汽车中。

总投资 3 亿美元的 ASMPT 智路资本先进封装材料项目签约落户中新苏滁高新区。

11 月 4 日，ASM 太平洋科技集团（ASMPT）、智路资本合资的先进封装材料项目（AAMI）签约仪式正式举行。先进封装材料项目（AAMI）由 ASMPT 集团联合中关村融信产业联盟核心成员智路资本牵头的财团共同投资建设，计划在中新苏滁高新区投资 3 亿美元，用地 181 亩，建设半导体封装材料生产项目，项目建成后将会成为国内最大的半导体封装材料生产基地。项目达产后，预计可实现年产值超 20 亿元，年纳税超 1 亿元。该项目的落户，将大大增强我市及周边区域集成电路产业配套能力，补足、加强半导体封装测试产业链条，促进相关产业进一步集聚发展。

小米长江产业基金、红杉资本、OPPO 等投资南芯半导体。近日，上海南芯半导体科技有限公司发生多项工商变更，新增股东湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、OPPO 广东移动通信有限公司、深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）等。上海南芯半导体科技有限公司成立于 2015 年 8 月，法定代表人为阮晨杰，经营范围包括从事半导体科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路、电子产品、计算机软硬件的研发、设计和销售等。目前南芯的芯片已经顺利进入华为、小米、海翼和欣旺达等知名厂商。公司从事集成电路芯片的研究、设计、开发和销售，提供应用系统参考设计方案，并提供相关的技术服务。

台积电 28NM 产能满载。据台媒 DigiTimes 报道，供应链表示，台积电 28nm 制程产能利用率过去始终未达预期，第 4 季度出现多年未见的满载情况。报道指出，其中，高通（Qualcomm），博通（Broadcom）将原在中芯 28nm 制程生产的产品提早转移过来，成为台积电 28nm 产能利用率达 100% 的主要原因。与目前的 5nm、7nm 工艺相比，28nm、40/45nm 尽管已推出较长时间，但它们仍在继续发挥作用，并在台积电营收中占有较大比重。

紫光国芯携手格芯，12 纳米制程推 GDDR6 记忆体控制器。清华紫光集团旗下的紫光国芯半导体（UniIC）于 3 日在晶圆代工厂格芯（Global foundries）举行的「全球技术论坛」（GTC）当中宣布，发表新产品「+ PHY IP」。 该产品是一款以格芯 12LP 平台为基础的第 6 代绘图用双倍数据传输率（GDDR6）记忆体控制器（MC）。与市面现有产品相比，新一代解决方案在功率、面积和成本上均有显着改善，足以应对人工智能（AI）和运算应用不断增长的需求。紫光国芯表示，旗下的 GDDR6 IP 所包含的记忆体控制器，不但可供配置，亦符合 DFI3.1 和 AMBAAXI4.0 等规范，使设计人员得以创造出具有最佳化延迟和频宽的 GDDR6 控制器，进而满足显示卡、游戏主机及 AI 运算等高效能应用的需求。

泰科天润 6 英寸碳化硅基电力电子芯片生产线项目力争年底竣工投产。据浏阳日报报道，总投资 5 亿元的泰科天润项目一期建设，目前正在进行设备安装，力争今年年底实现竣工投产，整个项目投产满产后，年产值预计可达到 13—14 亿元。据介绍，泰科天润项目是由泰科天润半导体科技（北京）有限公司投资建设的重点项目，项目分两期建设，一期总投资 5 亿元，主要建设 6 英寸碳化硅基电力电子芯片生产线，生产碳化硅芯片等产品。项目力争今年年底实现竣工投产，整个项目投产满产后，年产值预计可达到 13—14 亿元。

芯华章预告月内发布国内首个支持国产计算机架构的验证 EDA。2020 年 11 月 3 日，在湖南长沙召开的 2020 世界计算机大会上，芯华章科技创始人、董事长兼 CEO 王礼宾先生发表“数字经济双循环，EDA 技术突破正当时”的主题演讲。在演讲中，王礼宾先生重磅预告芯华章即将推出国内首个支持国产计算机架构的动态仿真技

术，属于验证 EDA 的核心领域之一。

ASML 中国展示 DUV 光刻机：对向中国出口光刻机保持开放态度。11 月 5 日，世界光刻机巨头荷兰阿斯麦 ASML 亮相第三届进博会。作为全球唯一能生产 EUV（极紫外光）光刻机的企业，由于 ASML 目前仍不能向中国出口 EUV 光刻机，所以此次展示的是其 DUV（深紫外光）光刻机。据悉，该产品可生产 7nm 及以上制程芯片。ASML 此次也带来了其整体光刻解决方案，包括先进控制能力的光刻机台计算光刻和测量通过建模、仿真、分析等技术，让边缘定位精度不断提高。

3.2 消费电子

SK 海力士：存储器价格整体趋弱，Q3 营业利润环比下降 33%。11 月 4 日，SK 海力士发布 2020 财年第三季度财务报告。公司第三季度结合并收入为 8.129 万亿韩元，营业利润为 1.3 万亿韩元，净利润为 1.078 万亿韩元。本季度营业利润率为 16%，净利润率为 13%。SK hynix 分析，尽管本季度移动端存储器需求展现了恢复趋势，然而由于服务器 DRAM 以及固态硬盘需求疲弱，导致本季度整体存储器市场价格趋弱，第三季度公司的营收及营业利润较上一季度分别减少了 6%及 33%。

韩媒：三星将向小米、VIVO 和 OPPO 供应全新 EXYNOS 系列 SOC。据韩国权威媒体 BusinessKorea 报道，三星系统 LSI 业务部表示将在 2021 年向中国智能手机制造商小米、OPPO 和 vivo 供应其用于智能手机的 Exynos 系列处理器（AP）。据报道，因其技术实力已获得认可，三星准备在 2021 年上半年为一上述企业的廉价手机（或者中低端机型）供应 AP，且表示可能在之后向其高端智能手机供应。由于低利润率，三星系统 LSI 业务部已开始减少向三星无线业务部门提供其 Exynos AP 的供应，并寻求以中国制造商为重点的新客户。IT 之家知悉，三星 Exynos 980 和 880 已成功打入 vivo 供应链并取得一定成绩。

触控芯片厂商义隆 10 月营收 3.3 亿元 业绩受晶圆厂产能吃紧影响。11 月 6 日消息，触控芯片厂商义隆日前公布了 10 月营收报告。义隆 10 月营收新台币 14.32 亿元（约合人民币 3.3 亿元），同比增长 44.61%。义隆表示，受到工作天数减少与晶圆厂产能吃紧，导致芯片供给不足的影响，单月营收较上月下滑 16.66%。

高通预计下一财季营收 78-86 亿美元 同比将大增。11 月 5 日消息，据国外媒体报道，高通公司在当地时间周三，公布了 2020 财年第四财季及全年的业绩，并给出了 2021 财年第一财季的业绩预期，预计营收同比仍将大涨，环比也有望增加。高通的财报显示，在截至 9 月 27 日的 2020 财年第四财季，他们在美国通用会计准则下的营收为 83.46 亿美元，同比增长 73%；净利润 29.6 亿美元，远高于上一财年同期的 5.06 亿美元。非美国通用会计准则下营收 65.02 亿美元，同比增长 35%；净利润 16.69 亿美元，同比增长 76%。在财报中，高通预计 2021 财年第一财季营收 78 亿美元到 86 亿美元，美国通用会计准则下摊薄之后每股的收益在 1.67 美元到 1.87 美元。

微美全息旗下公司拟收购新加坡飞达芯片 后者去年营收 7080 万美元。11 月 5 日消息，据外媒报道，全息 AR（增强现实）应用程序平台微美全息日前宣布，旗下子公司微易科技已就收购新加坡物联网解决方案提供商 Fe-da Electronics Company Pte Ltd（“新加坡飞达芯片公司”）100%的股权达成框架协议。微美全息表示，在新加坡飞达芯片公司满足某些协议条款的情况下，公司预期在未来两年内分几次结

清收购的款项。收购完成后，公司将合并新加坡飞达芯片公司的财务报表。微美全息介绍称，新加坡飞达芯片公司主营业务包括提供计算机和服务器之中央处理器（“CPU”）、存储装置包括 SSD 及 RAM 等半导体相关业务和个性化服务。整合后，公司计划保留并加强新加坡飞达芯片公司的团队，给公司在中央处理算法服务领域的发展带来很大的协同效应。

乐金显示将为苹果供应 Mini LED 面板 用于新一代 iPad Pro 产品。11 月 3 日消息，据国外媒体报道，韩国液晶面板制造商乐金显示（LG Display）将为苹果供应 Mini LED 面板，而苹果将把这种面板用于新一代 iPad Pro 产品上。据报道，苹果公司将从明年年初开始在 iPad 以及 MacBook 和 iMac 等其他产品上使用 Mini LED 显示屏。

4. 重点公司动态

兆易创新：三季度 NOR FLASH 需求超预期 目前供不应求。《科创板日报》2 日讯，兆易创新近日在电话会议中表示，公司 NOR Flash 三季度的价格比较稳定，需求非常旺盛，超过原来的预期。展望今年四季度，目前需求仍然非常旺盛，现在已经处于供不应求的状态，明年的景气度相对来讲还是比较乐观。

聚灿光电子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。聚灿光电 11 月 2 日晚间公告，子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司与中科院半导体研究所就建立“新型氮化物智慧光电联合实验室”达成合作协议。双方联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件；以实验室为基地，共同开展前沿基础性科研工作和人才培养，推动双方在技术及人才方面的全面提升。联合实验室的合作有效期为 3 年。

上海新阳拟募资用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目等。上海新阳 11 月 2 日公告，拟募集资金不超过 14.50 亿元（含），扣除发行费用后拟将 8.15 亿元用于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目，3.35 亿元用于集成电路关键工艺材料项目，3.00 亿元用于补充公司流动资金。

京东方 A：拟 4.25 亿元转让北旭电子 100%股权。11 月 5 日消息，京东方 A 发布公告称，为了集中精力发展主业，同时盘活公司存量资产，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司拟将其全资子公司北京北旭电子材料有限公司 100%股权进行对外转让。北旭电子作为独立的化工业务板块，与公司目前主营业务发展方向匹配度不高。此外，公司作为北旭电子的唯一股东，对北旭电子在显示面板领域的市场拓展带来一定的局限。根据公司战略规划，拟将北旭电子股权进行出售，盘活集团存量资产，取得一定的财务收益。同时，通过实现北旭电子股权结构多元化，促进北旭电子的市场化运营，进一步提高其市场份额及盈利水平。公告显示，北旭电子成立于 1993 年 11 月，是京东方下属全资子公司，主营业务为研发、生产、销售 TFT-LCD 用光刻胶及无机材料产品，是公司显示面板产业上游化工材料供应商之一。

5. 风险提示

下游需求低于预期；行业发展低于预期；疫情影响大于预期。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

本研究报告由申港证券股份有限公司研究所撰写，申港证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供申港证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

申港证券行业评级体系：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5%以上

市场基准指数为沪深 300 指数

申港证券公司评级体系：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15%以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%～15%之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5%以上